**技术创新需求调查表**

**企业信息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海鼎晖科技股份有限公司 | 机构代码 | 91310000703048385F |  |
| 区域 | 上海市-青浦区 | 联系人 | 杨丽 | 电话 | 13472737723 |  |
| 行业领域 |  | 新材料 | 产业领域 |  | 半导体封装 |  |
| 经济规模 |  | 8000万 | 人员规模 | 230 |  |
|  |  | **需求信息** |  |  |  |
|  | 技术需 | □ 技术研发（关键、核心技术） □ 产品研发（产品升级，新 |  |
|  | 产品研发） |  |  |  |  |
|  | 求类别 |  |  |  |  |
|  | √ 技术改造（设备，研发生产条件） □ 技术配套（技术，产 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | LAM技术是利用高能激光束将陶瓷和金属离子态化，让它们长 |  |
|  |  | 在一起使它们牢固的结合在一起。应用在大规模生产单面、双 |  |
|  |  | 面陶瓷线路板，可实现通孔盲孔的金属化产品，产品质量稳定 |  |
|  |  | 性好，将该技术用在LED封装技术上，将在很大程度上解决目 |  |
|  | 技术 | 前PCB板不易过孔、导热性能、膨胀系数的难题，因此会是未 |  |
|  | 来LED的发展趋势。 |  |  |  |
|  | 需求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 简述 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.传统PCB电路板不易过孔，但是LAM技术生产的双面陶瓷电 |  |
|  |  | 路板仅由金属层，陶瓷和金属层三部分而成，因为陶瓷本身不 |  |
|  |  | 导电，在绝缘性方面完全顶替了绝缘层，单面板亦是如此，与 |  |
| 技 |  | 以往的PCB相比将会轻薄很多，轻便易于组装。2.LED产品在 |  |
|  | 使用过程中一旦长时间作业，由于绝缘层导热率过低，产生的 |  |
| 术 |  |  |
|  | 高温无法及时散热，就很容易造成短路继而造成断路。使用 |  |
| 需 |  |  |
|  | LAM技术的陶瓷电路板在LED封装领域可以避免这种现象的发 |  |
| 求 |  |  |
|  | 生，此技术生产的陶瓷电路板采用无机陶瓷不含任何有机成分 |  |
| 情 |  |  |
|  | ，绝缘性好，不会导致断路和短路，因此耐高温耐击穿抗射线 |  |
| 况 |  |  |
| 技术 | 。3.LED行业芯片脱落的现象层出不穷，且无法焊接甚是影响 |  |
| 说 |  |
| 封装效果。LAM技术生产的陶瓷电路板有着更匹配的热膨胀系 |  |
| 需求 |  |
| 明 |  |
| 数，与芯片更贴合，随着芯片一起热胀冷缩，不会脱落，另外 |  |
| 详述 |  |
|  |  |
|  | 基板的可焊性好，还有着更牢更低阻的金属膜层，使得结合力 |  |
|  |  |  |
|  |  | 很强，最高可达45兆帕，优势明显。4.一般PCB电路板随着使 |  |
|  |  | 用寿命的长短而将光能转化为热能，使得照明效果不佳，且组 |  |
|  |  | 装密度过低，有很多杂乱无章的线路影响空间使用率。LAM技 |  |
|  |  | 术在LED的使用上高频损耗小，节能环保还可以高密度组装 |  |
|  |  | ，精细可插入更多的电子元器件，将LED效率发挥到极致。 |  |

现有 上海鼎晖科技有限公司专业从事LED器件封装及提供照明应用

基础 技术服务的高科技企业，承担国家科技部技术研究发展计划

情况 （863项目）LED研发课题及多项上海市市级LED研发项目，是

上海LED知名封装企业。专注生产高性能LED发光二极管

，LED数码管，LED矩阵，高功率LED器件及模组，COB形式LED光源，照明用LED日光灯及相关照明产品及技术服务。在青浦张江园拥有30亩的自有封装基地，30人的研发团队，目前开始拓展LAM技术的研究和开发。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 希望有专业的社会组织推介在LAM技术领域和封装领域有一定 |  |
|  |  | 建树的专家或团队，与公司进行共同研发和攻关，将LAM技术 |  |
|  |  | 应用到LED封装领域。 |  |
|  | 需求 |  |  |  |
|  | 描述 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |  |
| 学 |  |  |  |  |
| 研 |  |  |  |  |
| 合 |  |  |  |  |
| 作 |  |  |  |  |
| 需 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 求 | 合作方式 | □ 技术转让 □ 技术入股 √ 技术联合开发 □ 委托研发 |  |
|  | □ 委托团队、专家长期技术服务 √ 共建新研发、生产实体 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其 | □ 共建新研发、生产实体 □ 研发费用加计扣除 □ 知识产权 □ 科技金融 □ |  |
| 他 |  |
| 检验检测 √ 质量体系 □ 行业政策 √ 科技政策 √ 招标采购 □ 产品、服务 |  |
| 需 |  |
| 市场占有率分析 □ 市场前景分析 □ 企业发展战略咨询 □ 其他 |  |
| 求 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **管理信息** |  |
| 同意公开需求信息 | √ 是 | □ 否 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 同意接受技术服务 | √ 是 |  |  |
| □ 否 |  |  |
|  |  |  |  |

同意参与对解决方案 √ 是

的筛选评价 □ 否

□ 是，金额 万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件）

√ 否

同意对优秀解决方案

给予奖励

法人代表： 年 月 日